



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2022.2.11 (Y-Research RN009)

马鑫/第一财经研究院特约研究员

www.cbnri.com

研究简报

热点

美欧巨额资助芯片产业

摘要

近日，美国和欧盟先后公布了数额巨大的芯片资助计划，虽然美欧的法案仍需表决通过才能最终确定执行，但为芯片研究与制造提供巨额资金已经成为西方主要国家的共识。中国也需要积极出台更多利好芯片产业的政策，以应对国际竞争。

正文

马鑫/第一财经研究院特约研究员

近日，美国众议院通过了长达 3000 页的《2022 美国竞争法案》，其中包含将划拨 520 亿美元投资和补贴半导体制造行业。无独有偶，欧盟紧跟美国公布《芯片法案》，计划向新一代芯片工厂投资 420 亿欧元，以提升欧盟在全球的芯片生产的份额。当前，芯片产业的现状已经成为科技实力竞争的缩影，欧美等主要国家都在加大对芯片产业的投资，以期能够瓜分更多的芯片市场，掌握主动权。

一、美国强化芯片制造和研究能力

美国众议院法案大力增加芯片领域的投资，旨在强化美国制造和研究能力，提升美国竞争力和领导地位。该法案长达 2900 多页，共涉及近 3000 亿美元。其中，半导体领域占据资金最多，520 亿美元将以资助和补贴的形式，帮助半导体产业发展，包括 390 亿美元的生产 and 研发激励，以及 105 亿美元的项目计划，涵盖国家半导体技术中心、国家先进封装制造计划和其他研发计划等。

此外，还包括 450 亿美元以资金和贷款等形式，将用于增强高科技产品的供应链；105 亿美元将用于美国政府储备药品和医疗设备；80 亿美元将用于联合国的绿色气候基金，帮助贫穷国家应对气候变化；40 亿美元将用于帮助失业率高的社群；30 亿美元将用于帮助美国减少对中国光伏产品的依赖等。

众议院的文件还显示，拨款可以被用于将生产设施迁出受关注的国家，包括那些对美国构成重大经济或国家安全威胁的国家。美国政

府还可以利用拨款增加库存，以提供“在供应链冲击期间维持关键货物供应的必要储备”。除了资金安排，法案还将修改包括加强反倾销在内的一系列美国贸易规则等。

《2022 年美国竞争法案》虽在众议院获得通过，仍需要与参议院谈判，得到一个参众两院都能通过的折中版本后，送交白宫，由拜登签署后才能正式生效。但分析指出，鉴于众议院和参议院之间的争议，该法案以目前的形式颁布的可能性很小，但为芯片制造商提供资金的部分争议最小，英特尔和三星等半导体公司认为，这一措施将增加在美国投资的吸引力。

二、欧盟芯片法案旨在减少依赖

欧盟委员会 2 月 8 日正式公布欧盟《芯片法案》，计划向新一代芯片工厂投资 420 亿欧元，以使欧盟在 2030 年市场占有率较现阶段的 10% 翻倍到 20%。

根据这项计划，到 2030 年，欧盟计划对创新性的芯片研发和中试生产线建设提供 120 亿欧元的补贴，从而为未来的工业化做准备。其中 60 亿欧元来自欧盟，另外 60 亿来自成员国。另外 300 亿欧元的公共援助将用于建立大规模的芯片工厂，以及鼓励小公司的创新，这些资金包括用于吸引海外公司对欧洲的投资，比如英特尔。欧盟希望这些公共资助也能引发更多的私人投资。

欧盟委员会主席表示，将透过投资、监管以及与战略合作伙伴计划，使欧洲成为芯片产业的领导者，而理想观念相近的美国或日本将是欧盟战略合作伙伴。目前，该法案草案仍需获得成员国和欧洲议会通过。有分析指出，《芯片法案》标志着对竞争持有高度开放态度的

欧洲，在国际环境的压力下，也不得不实行干预主义工业政策的范式，以减少对外部的依赖。

除美欧之外，全球多数国家和地区的芯片企业都在积极扩大芯片产能，提升芯片技术。其中，三星宣布投资超 2000 亿美元到芯片领域内，并要赴美建厂；台积电计划投资 1000 亿美元。去年六月，台积电斥资 120 亿美元在美国亚利桑那州建设的芯片工厂已经动工，未来 10 至 15 年内台积电还将计划在亚利桑那州最多建设 6 座晶圆厂；英特尔已经宣布投资 200 亿美元建厂，并计划总投资 1000 亿美元到芯片领域内。多年来逐渐形成的集中于台湾和韩国的芯片产能也在这种压力下正发生变化，未来全球芯片产业格局或将面临重构。

近几年，中国对芯片产业相继出台了一系列产业政策。不过，鉴于中国芯片产业仍存在一定的短板，面对当前欧美又在加大对芯片产业的资金投入，中国也需要积极出台更多利好芯片产业的政策，以应对国际竞争。